



Grinding Wheels

UltraPoligrind

兼顾高抗折强度与去疵性

使用超细微钻石颗粒，兼顾高抗折强度与去疵性，实现晶圆薄化研磨新解决方案

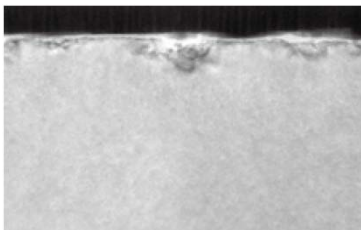
UltraPoligrind采用超细微钻石磨粒，实现比Poligrind更低的研磨破坏、更高的抗折强度。此外，即使经过应力消除制程，UltraPoligrind新型研磨轮仍可维持去疵性不降低。不使用化学物质的一般研磨加工，可减轻环境负荷、简化制程的薄化研磨方案。

- 减少对晶圆的破坏，实现高抗折强度
- 维持与一般研磨相同的去疵性

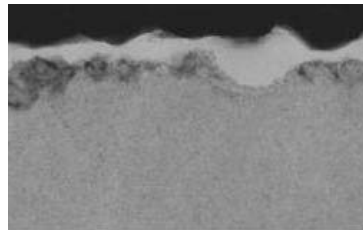


■晶圆破坏TEM比较

以UltraPoligrind研磨的晶圆，与Poligrind研磨轮相较之下，晶圆的破坏层明显缩小许多。



UltraPoligrind



Poligrind

加工对象

硅(矽)晶圆、其他材料

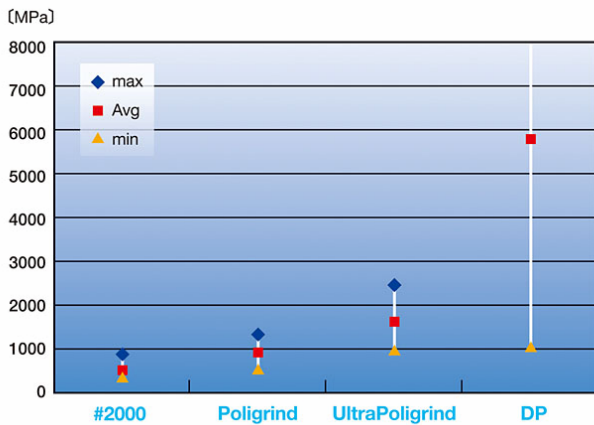
技术规格

PW08 - UA0140 300 × 3W × 7T - CT

研削齿品种	研削磨轮直径	研削齿宽度	研削齿高度	研削齿表示符号	研削齿形状	研削齿排列
UA0140	200 300 (mm)	3.0 (mm)	7.0 (mm)	CT	无研磨齿间隔	标准

实验结果

■ 抗折强度比较 (球压式抗折强度测量法)



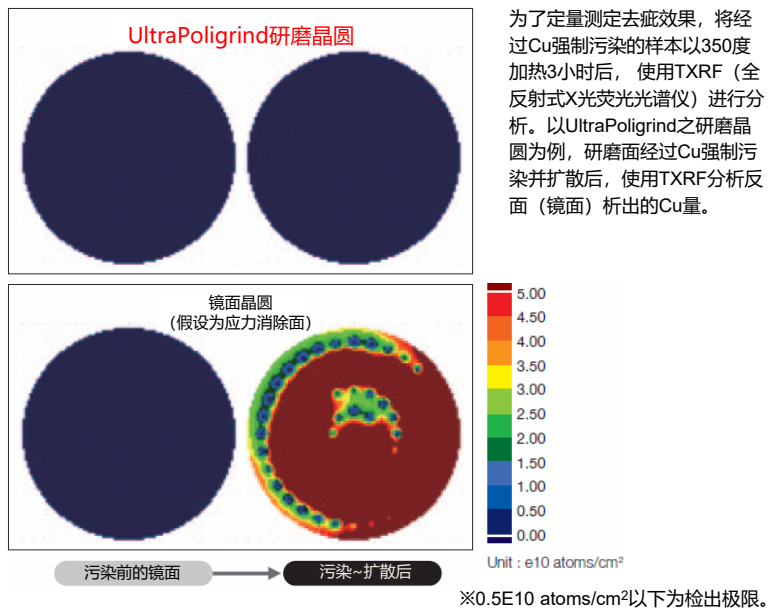
用户在使用UltraPoligrind时请注意

为了获得更高的加工质量，需要重新设定更佳加工条件。为此本公司的应用技术工程师将会根据用户的工作物和加工要求，竭诚为客户提供更佳加工方案。

■ 去疵效果

镜面晶圆之研磨晶圆经强制污染后从反面析出的Cu浓度高于 $1.0E11$ ，而UltraPoligrind之研磨晶圆从反面析出的Cu浓度却低于检出下限值，由此可知UltraPoligrind面具有去疵效果。

Cu强制污染前后的TXRF测量结果 (ø8寸镜面晶圆)



本公司的所有产品都已加入产品赔偿责任保险。

下订单时

在下订单时，请用户将产品的名称、外径、研削磨轮直径及数量通知本公司。另外在初次订购时，本公司销售窗口会根据不同加工要求，协助用户选择适合的产品。届时请一并提供研削材料、尺寸、形状、所用设备(装置)及其它相关加工条件等数据。
· 为了改进产品，本公司可能在未通知用户的情况下，就对产品规格进行变更，因此请仔细核对规格后再下订单。



为了安全使用本公司的各种产品

为了预防发生因研削磨轮、切割刀片(以下通称精密加工刀具)的破损而造成的各种事故和人身伤害，请严格遵守下列各注意事项。

- 请使用安全挡板 (包括喷嘴外壳或外盖)。
- 在使用注有限制旋转数的精密加工刀具时，请不要超出其规定的旋转数范围。
- 在安装精密加工刀具时，请遵照设备(装置)使用说明书的规定，正确地进行安装。
- 请不要使精密加工刀具掉落在地上，或发生碰撞。
- 在每次使用精密加工刀具前必须先进行检查，如果有缺口或其它破损，请停止使用。
- 在开始使用前，请先仔细阅读相关设备(装置)的使用说明书。
- 请不要使用经过改装的设备(装置)。
- 请不要使用不符合设备(装置)指定尺寸的精密加工刀具。
- 除了研削、切割及切削作业以外，请不要使用在其它用途。
- 在使用湿式研削、切割用精密加工刀具时，请使用冷却液。